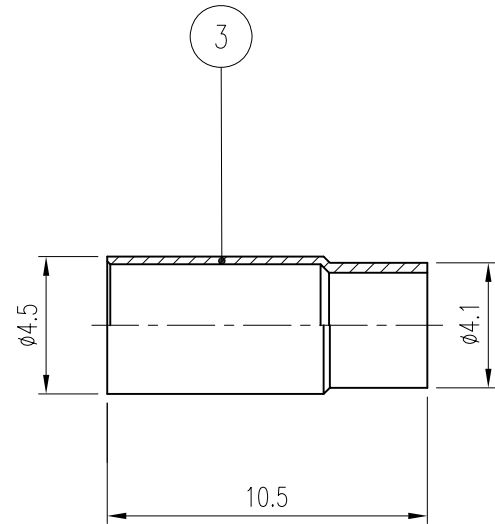
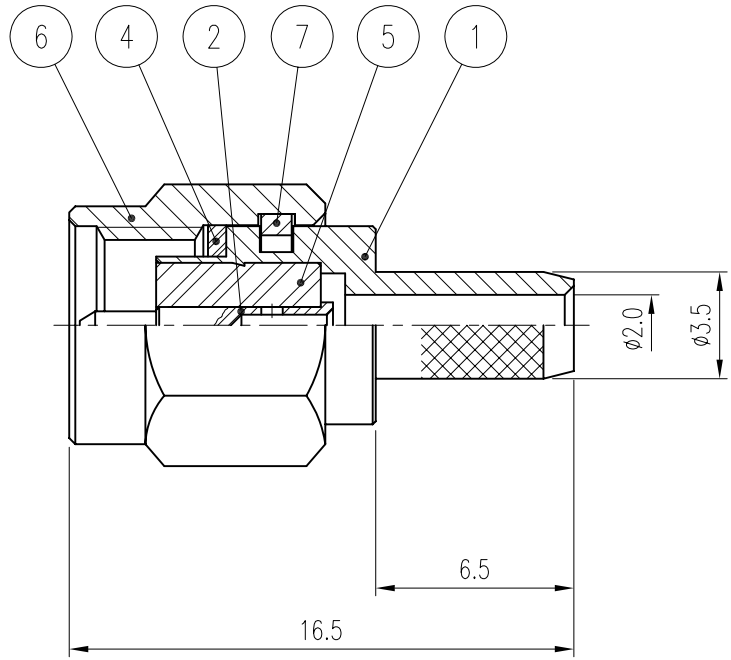


ST	가공									수 정 내 용				
										부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
ST(기초)									1 R	초도작성				2000. 11. 01.
ST(개선)									1	(실변처리No.201201-0011) BODY 내부 납시바를 추가	김인철	윤재호		2012. 02. 01.



7	SPRING RING	1	SUS	부동태처리	DSR00002-5/1 (R2001)
6	CAP	1	MBsBD	Gold Plate	DCU00005-5/1 (K2001)
5	ISULATOR	1	TEFLON		DIN00101-N/1 (H2069)
4	GASKET	1	SILICONE RUB		DGK00004-N/1 (G2001)
3	FERRULE	1	MBsBD	Nickel Plate	DFE00098-5/1 (F2018)
2	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT02033-5/1
1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD01843-5/1 (D2209)

△ 1		BODY		1		MBSBD		Gold Plate		DBD01843-5/1 (D2209)			
대체가능재질		품번		품 명		수량		재 질		표면처리		비 고	
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05		년월일		2012. 2. 1.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.							
		승인		J. H. YOUN									
		검도											
재질		제도		I. C. KIM		도명		SMA-PC-174					
열처리		작성부서		연 구 소		A4							도번 CN00956-7/1
보호파막처리		척도 1.5/1		단위 mm				중량		K314-001-004			